

## 伍、營運概況

### 一、業務內容

#### (一)業務範圍

##### 1. 所營業務之主要內容

- (1) F219010 電子材料零售業。
- (2) F113070 電信器材批發業。
- (3) F119010 電子材料批發業。
- (4) CC01050 資料儲存及處理設備製造業。
- (5) CC01070 無線通信機械器材製造業。
- (6) CC01080 電子零組件製造業。
- (7) F213060 電信器材零售業。
- (8) ZZ99999 除許可事業外得經營法令未禁止或限制之業務。

##### 2. 所營業務之營業比重

單位：新台幣千元

| 項 目        | 107年度     |         |
|------------|-----------|---------|
|            | 營業收入      | 比重(%)   |
| 高頻整合型元件及模組 | 1,738,584 | 96.36%  |
| 其他高頻陶瓷元件   | 65,724    | 3.64%   |
| 合 計        | 1,804,308 | 100.00% |

##### 3. 公司目前之產品(服務)項目

高頻整合型元件及模組，主要包括：

- (1) 濾波器(Filter)。
- (2) 平衡至非平衡阻抗轉換器(Balun)。
- (3) 平衡阻抗濾波器(Balanced Filter)。
- (4) 雙工器(Diplexer)。
- (5) 三工器(Triplexer)。
- (6) 耦合器(Coupler)。
- (7) 晶片天線(Antenna)。
- (8) 晶片天線模組(Antenna Module)。
- (9) 藍芽模組(Bluetooth Module)。
- (10) 射頻前端模組(Front-end Module)。
- (11) 天線開關模組(Antenna Switch Module)。
- (12) 高頻晶片陶瓷元件，主要包括電感及電容等被動元件。

#### (二)產業概況

##### 1. 產業現況與發展

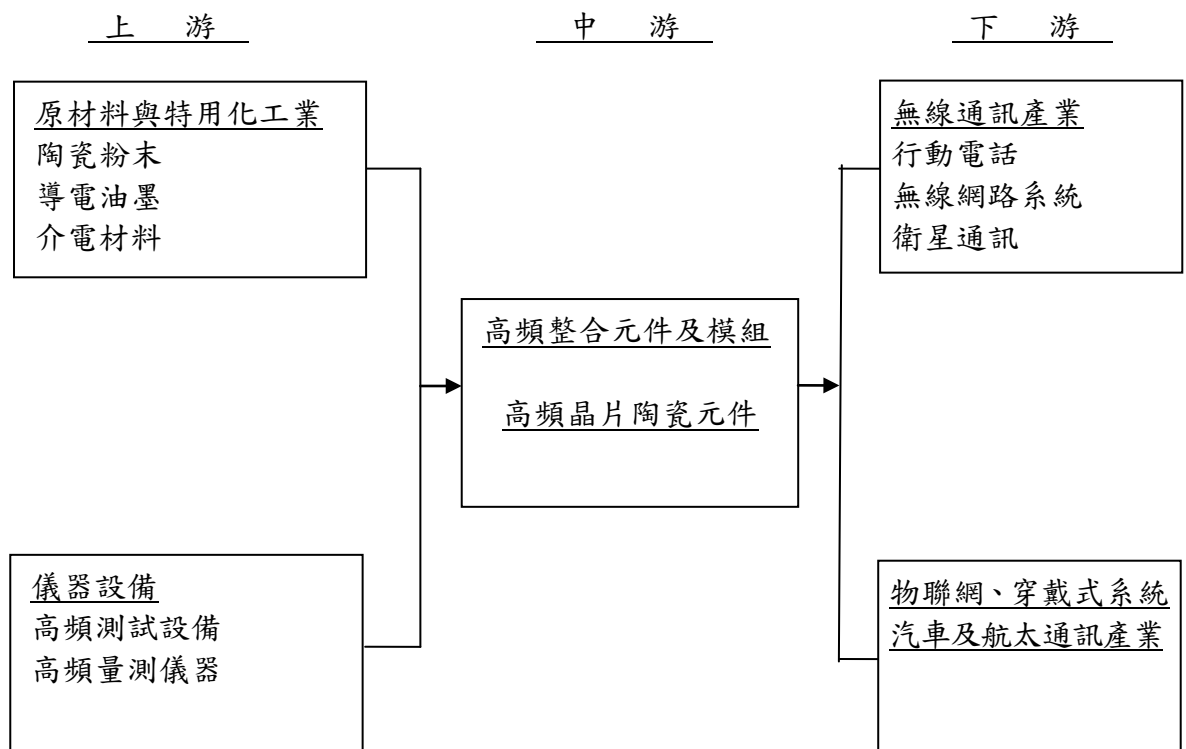
隨著電信自由化風潮的帶動，加上行動通訊技術的快速發展，相關終端產品及通訊設備的成長進一步帶動無線通訊的需求。無線通訊的終端應用範圍很廣，如行動電話、無線區域網路(WLAN)、藍芽(Bluetooth)、全球定位系統(GPS)、無線PC、無線電話、無線對講機、呼叫器、家庭無線(Home RF)、數位廣播、無線數據機、無線傳真機，以及新興的物聯網與穿戴裝置應用等等。由於全球市場對無線通訊應用的需求急速增加，使無線通訊的頻段大幅躍升，且由於無線可攜式產品小型化、多元功能及高傳輸速度的趨勢下，此即引發市場對高頻整合元件及模組的高度需求。

雖然系統愈趨複雜，但各種通訊系統實際所用的內部零組件數目卻日益整合，這主要歸因於線路的積體化，至於被動元件的積體化，目標乃朝向系統級封裝(System in a Package : SiP)或系統單晶片(System on a Chip : SoC)發展。由於終端產品內建各項無線通訊應用已是未來發展主流，模組化也必將成為通訊元件未來發展的趨勢，而高效能的元件模組化需要利用高密度的構裝製程，以通訊市場的供應鍊來看，擁有SiP高密度系統構裝技術的廠商，可提供上、下游整合性服務，未來將成為晶片設計及終端產品公司積極尋求的合作夥伴。

以近幾年無線通訊應用中大幅成長的手機、GPS、WLAN及Bluetooth為例，其功能、特性或市場雖有不同，但相同的是對所需零組件之高密度電路、小型化、高頻化、積體化及模組化的高度需求。本公司所經營之高頻整合元件及模組與高頻晶片陶瓷元件乃應用於無線通訊市場，為國內第一家且最具規模專注於RF整合元件與模組的設計及製造公司，因著所開發的產品符合市場期待且整合型的終端應用具高度成長動力下，本公司為國內RF通訊關鍵零組件產業中最具高度成長與發展潛力的公司。

## 2. 產業上、中、下游之關聯性

高頻整合元件及模組與高頻晶片陶瓷元件在上游原材料產業方面，主要包括陶瓷粉末、導電油墨及介電材料，主要製程儀器設備包括雷射打孔機、端銀機、連續爐、打線機、外檢機、射頻測試機及網路分析儀等。下游產業包括無線通訊產業、車用電子系統及航太通訊產業等，其與上中下游產業供需息息相關，茲將其上、中、下游產業關聯圖列示如下：



### 3. 產品之發展趨勢及競爭情形

無線通訊產品多功能化及小型化已成為市場趨勢，順應無線通訊元件的發展將朝向高頻化、小型化及模組化的方向發展。

近年來我國無線通訊蓬勃發展，無論是在行動電話、無線區域網路(WLAN)、全球定位系統(GPS)、藍芽(Bluetooth)、物聯網與穿戴裝置等主流應用都呈現高度成長，然而相對於國際大廠，我國在在無線通訊高頻元件及模組化技術的發展卻仍屬薄弱。目前全球整合元件大廠以日、美、歐為首，如日本的 Murata、Kyocera、TDK；美國的 CTS 及歐洲的 Bosch、CMAC 等大廠，反觀國內廠商，由於起步較晚，目前我國在全球市佔率中相對產值仍低。

有鑑於無線通訊的應用將是未來市場成長的核心，本公司積極開發具有前瞻性及創新的高頻元件及模組化尖端技術，以期掌握未來無線通訊成長的契機。

#### (三)技術及研發概況

1. 107年度投入研發費用為新台幣104,174千元。

2. 最近年度研發計劃、未完成研發計劃之目前進度、須再投入研發費用、預計完成量產時間及未來影響研發成功之主要因素：

##### (1)研究發展

由於本公司研發團隊同時在RF通訊及材料工程領域具備深厚的學術基礎及產品開發經驗，不論在技術發展及商業應用上均能掌握市場脈動。研究發展上則以有效提升RF元件整合度及模組化技術為二大重點方向，主要研發項目大致可分為技術分析、新產品開發、製程改善、材料配方及品質分析等構面。

##### (2)最近年度開發成功之技術或產品

| 年度   | 開發成功之技術或產品   |
|------|--|
| 107年 | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 開發完成尺寸3.2mmx2.5mm，IoT系統使用之電源轉換模組。</li><li>2. 開發完成尺寸15mmx4.0mm，無線通訊系統使用之雙頻天線。</li><li>3. 開發完成尺寸0.9mmx0.7mm，2.4GHz通訊系統使用之小型帶通濾波器。</li><li>4. 開發完成尺寸5.0mmx5.0mm，IoT系統使用之直流電源轉換器。</li><li>5. 開發完成尺寸3.0mmx3.0mm，NB-IoT雙頻系統使用之平衡式天線收發開關模組。</li><li>6. 開發完成尺寸1.6mmx0.8mm，2.0GHz通訊系統使用之帶通濾波器。</li><li>7. 開發完成尺寸3.2mmx2.5mm，5.2GHz通訊系統使用之高抑制能力帶通濾波器。</li><li>8. 開發完成尺寸3.2mmx1.6mm，NFC系統使用之天線。</li><li>9. 開發完成尺寸2.0mmx1.25mm，900MHz/2400MHz雙頻系統使用之平衡至非平衡阻抗轉換器。</li><li>10. 開發完成尺寸1.6mmx0.8mm，3.8GHz通訊系統使用之帶通濾波器。</li><li>11. 開發完成尺寸3.2mmx2.5mm，700MHz通訊系統使用之低通濾波器。</li><li>12. 開發完成尺寸1.6mmx0.8mm，4.7GHz通訊系統使用之帶通濾波器。</li><li>13. 開發完成尺寸3.2mmx2.5mm，4.9GHz通訊系統使用之平衡至非平衡阻抗轉換濾波器。</li><li>14. 開發完成尺寸1.6mmx0.8mm，5.4GHz通訊系統使用之帶通濾波器。</li><li>15. 開發完成尺寸1.6mmx0.8mm，LTE通訊系統使用之雙工器。</li><li>16. 開發完成尺寸1.6mmx0.8mm，0.8GHz通訊系統使用之帶通濾波器。</li><li>17. 開發完成尺寸1.6mmx0.8mm，WLAN雙頻系統使用之高隔離度雙工器。</li><li>18. 開發完成尺寸1.6mmx0.8mm，5.5GHz通訊系統使用之帶通濾波器。</li><li>19. 開發完成尺寸3.2mmx2.5mm，LNB 2.0GHz通訊系統使用之平衡至非平衡阻抗轉換濾波器。</li><li>20. 開發完成尺寸0.9mmx0.7mm，2.4GHz通訊系統使用之薄型低通濾波器。</li><li>21. 開發完成尺寸1.6mmx0.8mm，5G通訊系統使用之帶通濾波器。</li></ol> |

| 年度   | 開發成功之技術或產品  |
|------|---|
| 107年 | 22. 開發完成尺寸2.5mmx2.0mm，1.7GHz/4.6GHz通訊系統使用之雙工器。<br>23. 開發完成尺寸1.0mmx0.5mm，LTE通訊系統使用之平衡至非平衡阻抗轉換濾波器。<br>24. 開發完成尺寸2.0mmx1.25mm，7.4GHz通訊系統使用之帶通濾波器。<br>25. 開發完成尺寸1.6mmx0.8mm，WLAN雙頻系統使用之雙工器。<br>26. 開發完成尺寸1.0mmx0.5mm，800MHz通訊系統使用之低通濾波器。<br>27. 開發完成尺寸2.0mmx1.25mm，5.5GHz通訊系統使用之帶通濾波器。<br>28. 開發完成尺寸3.2mmx1.6mm，2.0GHz通訊系統使用之帶通濾波器。<br>29. 開發完成尺寸3.2mmx2.5mm，4.9GHz通訊系統使用之帶通濾波器。<br>30. 開發完成尺寸3.2mmx2.5mm，5.6GHz通訊系統使用之高抑制能力帶通濾波器。<br>31. 開發完成尺寸4.5mmx3.2mm，5.9GHz通訊系統使用之高抑制能力帶通濾波器。<br>32. 開發完成尺寸2.0mmx1.25mm，400MHz通訊系統使用之1:1平衡至非平衡阻抗轉換雙工器。<br>33. 開發完成尺寸1.0mmx0.5mm，2.4GHz通訊系統使用之低通濾波器。<br>34. 開發完成尺寸2.0mmx1.25mm，0.8GHz/2.1GHz通訊系統使用之雙工器。<br>35. 開發完成尺寸2.0mmx1.25mm，400MHz通訊系統使用之1:4平衡至非平衡阻抗轉換雙工器。<br>36. 開發完成尺寸1.0mmx0.5mm，LTE通訊系統使用之低通濾波器。<br>37. 開發完成尺寸1.0mmx0.5mm，4.7GHz通訊系統使用之薄型耦合器。<br>38. 開發完成尺寸2.0mmx1.25mm，1.3GHz通訊系統使用之平衡式低通濾波器。<br>39. 開發完成尺寸1.6mmx0.8mm，1.2GHz/2.0GHz通訊系統使用之雙工器。<br>40. 開發完成尺寸1.0mmx0.5mm，5.6GHz通訊系統使用之平衡至非平衡阻抗轉換濾波器。<br>41. 開發完成尺寸1.6mmx0.8mm，WLAN雙頻系統使用之低損耗雙工器。<br>42. 開發完成尺寸1.6mmx0.8mm，1.9GHz通訊系統使用之低通濾波器。<br>43. 開發完成尺寸1.6mmx0.8mm，WLAN雙頻系統使用之高抑制能力雙工器。<br>44. 開發完成尺寸1.6mmx0.8mm，LTE通訊系統使用之平衡至非平衡阻抗轉換濾波器。<br>45. 開發完成尺寸2.0mmx1.25mm，1.3GHz/2.5GHz通訊系統使用之雙工器。<br>46. 開發完成尺寸1.6mmx0.8mm，WLAN 2.4GHz通訊系統使用之低通濾波器。<br>47. 開發完成尺寸2.0mmx1.25mm，WLAN雙頻系統使用之雙工器。<br>48. 開發完成尺寸1.6mmx0.8mm，2.4GHz通訊系統使用之複數阻抗平衡至非平衡阻抗轉換濾波器。<br>49. 開發完成尺寸2.0mmx1.25mm，WLAN雙頻系統使用之低損耗雙工器。<br>50. 開發完成尺寸1.6mmx0.8mm，WLAN 5.4GHz通訊系統使用之低通濾波器。<br>51. 開發完成尺寸2.0mmx1.25mm，WLAN雙頻系統使用之高隔離度雙工器。<br>52. 開發完成尺寸3.2mmx2.5mm，LNB 1.5GHz通訊系統使用之平衡至非平衡阻抗轉換濾波器。<br>53. 開發完成尺寸1.6mmx0.8mm，2.2GHz通訊系統使用之低通濾波器。 |

(3) 未完成研發計劃之目前進度、須再投入研發費用及預計完成量產時間

| 107年未完成之研發計畫    | 目前進度 | 預計完成量產時間   | 須再投入研發費用(千元) |
|-----------------|------|------------|--------------|
| 開發縮小化整合型元件      | 90%  | 108年/Q3-Q4 | 8,000        |
| 開發縮小化多頻、多模整合型模組 | 75%  | 108年/Q3-Q4 | 15,000       |
| 高精密度材料、製程開發     | 85%  | 108年/Q2-Q3 | 6,000        |

(4)未來影響研發成功之主要因素

- ①正確的研發策略並有效掌握產品開發時程，以達到產品time to market。
- ②良好的產品設計能力，及早有效 Design-in 客戶端之產品設計。
- ③優秀穩定的研發團隊，使研發經驗可有效累積並推升產品開發能力。

(5)未來研發計劃及預計投入之研發費用

| 未來研發計畫          | 未來三年預計投入<br>研發費用(千元) |
|-----------------|----------------------|
| 開發縮小化整合型元件      | 125,000              |
| 開發縮小化多頻/多模整合型模組 | 170,000              |
| 高精密度材料/製程開發     | 90,000               |
| 總計              | 385,000              |

(四)長短期業務發展計劃

1.短期發展計劃

- (1)模組化開拓主力產品。
- (2)產品小型化及多功能化。
- (3)強化中國及新興市場的開發。

2.長期發展計劃

- (1)模組化開拓新興產品。
- (2)系統級封裝技術的開發。
- (3)策略聯盟的合作模式。

## 二、市場及產銷概況

### (一)市場分析

#### 1. 主要產品(服務)之銷售地區

單位：新台幣千元

| 年度<br>銷售區域 |    | 106年度     |        | 107年度     |        |
|------------|----|-----------|--------|-----------|--------|
|            |    | 金額        | %      | 金額        | %      |
| 內銷         |    | 364,937   | 18.59  | 295,487   | 16.38  |
| 外銷         | 美洲 | 621,512   | 31.65  | 558,905   | 30.98  |
|            | 亞洲 | 964,642   | 49.13  | 936,704   | 51.91  |
|            | 歐洲 | 12,399    | 0.63   | 13,212    | 0.73   |
|            | 小計 | 1,598,553 | 81.41  | 1,508,821 | 83.62  |
| 合計         |    | 1,963,490 | 100.00 | 1,804,308 | 100.00 |

#### 2. 市場占有率

近年來由於無線通訊市場蓬勃發展，帶動了低溫陶瓷(LTCC)元組件產業呈現大幅成長，根據Market Insights Reports估計，2018年LTCC全球年產值約32億美元，供應鏈中以日本為最大的供應國，市場佔有率高達50%，主導了全球LTCC產品市場及技術，其次為美國與歐洲，而國內廠商由於起步較晚，相對市場佔有率仍低。

本公司所生產的高頻整合型元件、模組及高頻晶片陶瓷元件，主要包括濾波器、平衡至非平衡阻抗轉換器、平衡阻抗濾波器、雙工器、三工器、耦合器、晶片天線、晶片天線模組、藍芽模組、射頻前端模組、天線開關模組、電感及電容等被動元件，普遍應用在行動電話、無線區域網路、藍芽、GPS、物聯網與穿戴裝置等終端設備。由於本公司為國內早期投入且專營RF整合元件與模組的公司，當產品進入市場後，以優良的品質、具競爭力的價格與高時效的服務，在很短時間內即獲得國內外客戶的肯定，目前在技術層次及市場佔有率上均居國內領導地位，全球市佔有率約2%。

#### 3. 市場未來之供需狀況與成長性

隨著全球電信自由化及通訊技術的精進，無線通訊已成為3C產業中最具成長動能的產業，展望未來，當終端產品都走向整合的趨勢下，手機的普及率及可攜式具有絕佳的競爭優勢以整合其他產品功能，其中智慧型手機即是典型的代表。智慧型手機在具備愈來愈強的運算及多媒體功能後，衍生出上網、下載及分享等功能，此即需要有更多元的傳輸管道、更高的傳輸頻寬及更優質的傳輸效率，因此也引發手機目前及未來將結合的各種通訊功能，從區域的WLAN，短距的Bluetooth及ZigBee，到長距的WiMAX，再加上GPS與行動電視功能，將語音、數據與視訊等多功能結合，打造了全方位的通訊平台。IDC預估，隨著平板手機風潮及5G的興起，智慧型手機全球出貨於2022年將達15.7億支；GPS因車用導航定位服務在全球各地的擴展，也將是未來幾年具高成長潛力的產品；至於新興的物聯網應用，從個人穿戴裝置、智慧家庭、智慧製造、智慧健康及智慧交通等智慧應用的快速發展，Gartner估計2020年物聯網串連的相關裝置可高達208億台，預期未來物聯網所帶來的經濟效益將十分可觀。

本公司所經營的RF元件及模組為無線通訊產品必需使用的關鍵零組件，行動電話、電腦、無線網路、全球衛星定位系統、物聯網及穿戴裝置等通訊產品直接牽動了LTCC未來市場的發展。由於現行主流的無線通訊應用在未來幾年仍呈現高度成長以及未來新興通訊產品也朝向多功能整合發展的趨勢下，市場對本公司所生產的整合元件及模組產品將會有更高的需求。

#### 4. 競爭利基

##### (1) 兼具四大核心技術

本公司擁有產業中極少能夠同時具備之先進 RF 電路設計、材料開發、製程設計及產品測試等四大核心技術，由於自主掌控 RF 及材料二大領域的關鍵技術，有能力提供高效率的客製化產品及服務。

##### (2) 產品定位符合市場發展主流

無線通訊為近年來最具成長動力的產業，其中尤以行動通訊的成長幅度最大，隨著終端產品的大幅成長，將直接帶動對本公司產品的需求。此外，由於行動通訊多元功能及微型化的趨勢，本公司以 SiP 及 LTCC 製程所開發之高頻整合元件及模組正符合市場期待，將更進一步推升市場需求，使本公司成長前景看好。

##### (3) 優質產品服務

結合研發及製程優勢，本公司可提供相較於國際同業更具時效性、高客製化、彈性並具成本競爭優勢的全方位服務，以贏得客戶的高度信賴和認同。

#### 5. 發展遠景之有利、不利因素與因應對策

##### (1) 有利因素

- ① 產業高度成長
- ② 技術領先國內同業
- ③ 國內居首並進軍國際
- ④ 高競爭力全方位服務
- ⑤ 兼顧品牌及代工模式

##### (2) 不利因素與因應對策

① 無線通訊產品推陳出新，產品週期短且價格下滑快，擠壓獲利空間。

因應對策：

- A. 縮短新產品開發時程，致力於高階產品，避開價格戰的成熟型產品。
- B. 以設計導入(Design-in)，於客戶產品設計階段即參與產品開發。
- C. 以多元化產品，分散單一產品價格競爭之風險。
- D. 強化製程改善，提升良率與設備稼動並降低成本。

② 研發人才缺乏

因應對策：

- A. 積極參與國內工業局主導性新產品計劃並爭取國外技術移轉或共同開發機會，以刺激研究發展與技術升級。
- B. 建立研發知識管理資料庫，使研發經驗與成果有效傳承，發揮最高研發人力效益。

#### (二) 主要產品之重要用途及產製過程

##### 1. 主要產品之重要用途

| 產品種類                  | 重要用途  |
|-----------------------|---|
| 高頻整合元件及模組<br>高頻晶片陶瓷元件 | 行動衛星電話(MSS)、蜂巢式行動電話(Cellular Phone)、無線電話(Cordless Phone)、無線區域網路(Wireless LAN、HyperLAN)、GPS(全球定位系統)、藍芽(Bluetooth)、UWB(超寬頻)、WiMAX(全球微波存取互通)、ZigBee、MIMO(多重輸入輸出)、Wi-Fi、功率放大器(PA)、衛星降頻器(LNB)、家用無線收發器(Home RF)、物聯網、穿戴式裝置等。 |

## 2. 產製過程

原料→漿料配置→刮刀成型→沖孔→填孔→網印→疊壓→切割→燒結→上端電極→  
燒附→電鍍→電性測試→包裝→出貨

### (三) 主要原料之供應狀況

| 主要原料名稱 | 主要供應商            | 供應狀況 |
|--------|------------------|------|
| 陶瓷粉末   | 杜邦、台灣賀利氏         | 良好   |
| 導電油墨   | 杜邦、台灣賀利氏、台灣雙日、大洲 | 良好   |



(四)最近二年度進銷貨總額百分之十以上之客戶名單

1. 最近二年度進貨總額百分之十以上之供應商名單

單位：新台幣千元

| 項次   | 106年度 |         |               |        | 107年度 |         |               |        | 108年第一季 |        |                     |        |
|------|-------|---------|---------------|--------|-------|---------|---------------|--------|---------|--------|---------------------|--------|
|      | 名稱    | 金額      | 占全年度進貨淨額比率(%) | 與本公司關係 | 名稱    | 金額      | 占全年度進貨淨額比率(%) | 與本公司關係 | 名稱      | 金額     | 占當年度截至第一季止銷貨淨額比率(%) | 與本公司關係 |
| 1    | a     | 32,931  | 13.61         | 無      | a     | 30,376  | 12.65         | 無      | a       | 6,755  | 12.60               | 無      |
| 2    | b     | 29,463  | 12.18         | 無      | c     | 27,422  | 11.42         | 無      | -       | -      | -                   |        |
| 3    | c     | 29,041  | 12.01         | 無      | b     | 25,902  | 10.79         | 無      | -       | -      | -                   |        |
| 4    | -     | -       | -             | -      | d     | 25,139  | 10.47         | 無      |         | -      | -                   |        |
| 5    | 其他    | 150,450 | 62.20         |        | 其他    | 131,313 | 54.67         |        | 其他      | 46,863 | 87.40               |        |
| 進貨淨額 |       | 241,885 | 100.00        |        | 進貨淨額  | 240,152 | 100.00        |        | 進貨淨額    | 53,618 | 100.00              |        |

2. 最近二年度銷貨總額百分之十以上之客戶名單

單位：新台幣千元

| 項次   | 106年度 |           |               |        | 107年度 |           |               |        | 108年第一季 |         |                     |        |
|------|-------|-----------|---------------|--------|-------|-----------|---------------|--------|---------|---------|---------------------|--------|
|      | 名稱    | 金額        | 占全年度銷貨淨額比率(%) | 與本公司關係 | 名稱    | 金額        | 占全年度銷貨淨額比率(%) | 與本公司關係 | 名稱      | 金額      | 占當年度截至第一季止銷貨淨額比率(%) | 與本公司關係 |
| 1    | A     | 483,241   | 24.61         | 註1     | A     | 399,080   | 22.12         | 註1     | A       | 99,932  | 23.47               | 註1     |
| 2    | 其他    | 1,480,249 | 75.39         |        | 其他    | 1,405,228 | 77.88         |        | 其他      | 325,920 | 76.53               |        |
| 銷貨淨額 |       | 1,963,490 | 100.00        |        | 銷貨淨額  | 1,804,308 | 100.00        |        | 銷貨淨額    | 425,852 | 100.00              |        |

註1：該公司為本公司法人董事。

## (五)最近二年度生產量值表

單位：仟顆；千元

| 年度<br>生產量值<br>主要商品    | 106年度     |           |         | 107年度     |           |         |
|-----------------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|
|                       | 產能        | 產量        | 產值      | 產能        | 產量        | 產值      |
| 高頻整合元件及模組<br>高頻晶片陶瓷元件 | 2,850,000 | 2,631,428 | 722,240 | 2,900,000 | 2,761,006 | 688,513 |

## (六)最近二年度銷售量值表

單位：仟顆；千元

| 年度<br>銷售量值<br>主要商品    | 106年度   |         |           |           | 107年度   |         |           |           |
|-----------------------|---------|---------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|
|                       | 內銷      |         | 外銷        |           | 內銷      |         | 外銷        |           |
|                       | 量       | 值       | 量         | 值         | 量       | 值       | 量         | 值         |
| 高頻整合元件及模組<br>高頻晶片陶瓷元件 | 727,132 | 364,937 | 1,863,593 | 1,598,553 | 700,103 | 295,487 | 1,975,218 | 1,508,821 |

## 三、從業員工

| 年              | 度    | 106年度 | 107年度 | 截至<br>108年3月31日 |
|----------------|------|-------|-------|-----------------|
| 員工<br>人數       | 直接人員 | 158   | 162   | 159             |
|                | 間接人員 | 44    | 41    | 38              |
|                | 管銷人員 | 35    | 34    | 33              |
|                | 研發人員 | 45    | 44    | 43              |
|                | 合計   | 282   | 281   | 273             |
| 平均年歲           |      | 35.6  | 35.8  | 36              |
| 平均服務年資         |      | 6.06  | 6.52  | 6.73            |
| 學歷<br>分佈<br>比例 | 博士   | 2.8%  | 2.5%  | 2.5%            |
|                | 碩士   | 17.4% | 16.0% | 15.8%           |
|                | 大專   | 42.2% | 46.3% | 45.1%           |
|                | 高中   | 30.1% | 28.1% | 28.9%           |
|                | 高中以下 | 7.5%  | 7.1%  | 7.7%            |

## 四、環保支出資訊

(一)最近年度及截至年報刊印日止，本公司因污染環境所受損失(包含賠償)及處分之總額：無此情事。

(二)未來因應對策及可能之支出：不適用。

## 五、勞資關係

(一)公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形，以及勞資間之協議情形：

### 1. 員工福利措施

- (1)員工酬勞：於公司章程第25條規定，當年度如有獲利則提撥不低於5%水準，並考量整體經營結構及產業分配情況提列員工酬勞。
- (2)獎金制度：除員工酬勞外，依公司營運狀況提供具高度競爭力獎金制度，包括三節獎金、績效獎金、營運獎金…等，以激勵士氣並留任優秀員工。
- (3)年度調薪制度：依公司獲利狀況、整體經濟環境、同業間水平及員工個人貢獻度與績效評核結果進行整體調薪。
- (4)免費健康檢查：員工定期實施健康檢查，並依檢查結果進行分級健康管理，實施追蹤複檢及健康衛教。
- (5)完善的保險計劃：員工自到職日起，即享有勞工保險、全民健康保險及團體保險。
- (6)貼心工作環境：本公司設有免費室內停車位、員工休息室、哺乳室及員工餐廳等設施，並提供員工團膳餐費補助。
- (7)福委會福利項目：各項旅遊活動、聯歡餐會、抽獎及各類活動；年節、生日禮金、婚喪喜慶等各項福利補助。

### 2. 員工進修及訓練情形

本公司依「員工教育訓練管理程序」，按員工專業職能及學習需要規劃相關培訓課程。

#### (1)訓練體系

- ①工作指導式訓練：單位主管對部屬的平日工作指導或工作職掌內的訓練。
- ②集中式訓練：考量人力資源發展，組織目標及員工教育訓練需求，提出年度教育訓練計畫。
  - A. 新進人員訓練：新進人員應接受職前訓練。
  - B. 職能別訓練：加強本職專業技能。
  - C. 通識課程：企業社會責任、資訊安全、職業安全與衛生及自我啟發等課程。
- ③管理才能訓練：基層主管、中階主管、高階主管所排定訓練課程。

#### (2)本年度教育訓練執行情形彙總

| 課程名稱           | 內部訓練  |        | 外部訓練 |        |
|----------------|-------|--------|------|--------|
|                | 受訓人次  | 費用(千元) | 受訓人次 | 費用(千元) |
| 通識課程           | 1,758 | -      | 8    | 23.5   |
| 職能-管理能力訓練      | -     | -      | -    | -      |
| 職能-專業技能訓練(集合式) | 112   | -      | 12   | 25.0   |
| 職能-專業技能訓練(OJT) | 278   | -      | -    | -      |
| 總計             | 2,148 | -      | 21   | 48.5   |

### 3. 員工退休制度

(1)本公司依據勞動基準法之規定訂定員工退休辦法，組成勞工退休準備金監督委員會，依每月薪資總額提撥2%之勞工退休準備金儲存於勞工退休基金專戶中，做為未來支付勞工退休準備金之用。本公司並依國際會計準則第十九號員工福利中確定給付退休辦法依合格精算師出具之退休金精算報告，於帳上提列退休金、承認退休金負債。

(2)本公司於自94年7月1日起，本公司依據勞工退休金條例，訂有確定提撥之退休辦法，並就員工選擇適用勞工退休金條例部分，每月按不低於薪資之6%提繳勞工退休金至勞保局員工個人帳戶，員工退休金之支付依員工個人之退休金專戶及累積收益之金額採月退休金或一次退休金方式領取。

### 4. 勞資間之協議情形

本公司是一個開放式的管理環境，管理階層與員工間隨時有各種形式的討論與溝通，任何問題都可以即時以互動溝通方式達到一致的共識，並關心同仁間的互動與溝通，讓員工和公司之間能夠透過彼此的溝通與了解，達到共同成長與茁壯的目的，本公司建構一個具有挑戰性且富有學習機會的工作環境，勞資之間關係和諧，因此並未發生勞資糾紛。

5. 各項員工權益維護措施情形：依勞動基準法規定辦理。

(二)列明最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施：無。

### 六、重要契約：

| 契約性質 | 當事人          | 契約起訖日期        | 主要內容   | 限制條款 |
|------|--------------|---------------|--------|------|
| 營造   | 旭源營造工程股份有限公司 | 106.11~109.03 | 廠房新建工程 | 無    |